

鴻海科技集團宣布與英特爾策略合作 強強聯手！攜手推動 AI Rack、Edge AI 及 Physical AI 次世代平台發展

2026 年 6 月 4 日—鴻海科技集團（TWSE：2317）宣布與英特爾將進行策略合作，結合英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系的優勢，及鴻海在全球製造、系統整合與 AI 資料中心部署能力上的深厚基礎，雙方將共同探索從晶片、機櫃、系統到應用的全方位 AI 解決方案，並加速由 AI 驅動的技術推動邊緣和 Physical AI 應用。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「AI 正快速重塑全球產業與社會運作模式，鴻海憑藉『3+3+3』策略，積極布局 AI、半導體與次世代通訊等核心技術，並推進智慧製造、智慧電動車與智慧城市三大平台發展。此次與英特爾的合作，將結合雙方在運算平台、系統整合與全球供應鏈的優勢，共同打造新世代 AI Infrastructure、Edge AI 與 Physical AI 生態系，加速 AI 應用落地。」

英特爾執行長陳立武表示：「AI 的快速成長，尤其是大規模推論與代理式 AI 工作負載的興起，正在重新定義現代運算所需具備的能力。這些需求仰賴橫跨整個技術堆疊的全面創新，涵蓋從新一代矽晶與晶片設計、機櫃級系統，到邊緣 AI 與 Physical AI 的部署。我們與鴻海的合作，匯聚雙方在晶片設計、機櫃級解決方案，及全球系統整合上的深厚專業。雙方將共同加速端到端平台的發展，釋放更多全新能力，並進一步擴大 AI 在全球的影響力。」

根據合作內容，雙方將結合英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系的優勢，及鴻海在系統整合、全球製造規模與客戶服務能力上的深厚基礎，共同推動由 AI 驅動的解決方案的規模化部署。

首先，在 AI 機櫃（AI Rack）領域，雙方將探索開發與商業化機櫃級 AI 基礎設施解決方案，涵蓋以 Intel Xeon 處理器為基礎的機櫃與 AI 加速器架構，並共同推進高速互連（interconnect）、散熱與液冷設計、系統監測，以及 AI 資料中心擴充性等關鍵技術，提供更高效能與高能源效率的 AI 部署解決方案。

雙方在邊緣和 Physical AI 領域，將共同定義下一代邊緣 AI 與 Physical AI 平台架構，布局 Agentic AI、終端智慧與機器人等應用方向。此合作將進一步推動和支援智慧製造、智慧城市、車用與機器人等多元場景。

此外，雙方亦將探索於客製化 ASIC、SoC 與系統整合等設計服務上的合作機會，結合英特爾的完整晶片能力與鴻海完整的設計製造生態系，此合作涵蓋晶片、模組與系統，將拓展全球市場商機。

【媒體聯絡人】

英特爾台灣分公司

台灣公關

許雅婷 Carol Hsu

E-mail：carol.hsu@intel.com

利眾公關

吳湘雲 Phina Wu

+886-911-760-780

E-mail：phina@oneforall.com.tw

陳時瑩 Noelle Chen

+886-912-560-245

E-mail：noelle@oneforall.com.tw